联络人
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204 / 1202
ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2021 年第四季自结财务报告

2021 年 2 月 11 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(11)日公告 2021 年第四季自结财务报告。

2021 年第四季财务概况

- 本季合并营收新台币 72.17 亿元，较前季增加 7%，较去年同期增加 5%
- 本季合并毛利率为 40.5%，较前季增加 1.7 个百分点；本季营业净利率为 27.8%，较前季增加 1 个百分点
- 本季营业净利为新台币 20.09 亿元，较前季增加 11%，较去年同期增加 21%
- 本季税后净利为新台币 16.9 亿元，较前季增加 13%，较去年同期增加 32%；每股盈余为新台币 4.19 元，前季为新台币 3.67 元

2022 年第一季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 第一季因晶圆厂陆续岁休保养以及传统淡季，营收预计较前一季下滑 low-twenties 百分比。
- 第一季毛利率预计约为 mid-thirties 的水平。

免责声明
本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

"2021年第四季客户需求在延续第三季的动能之下持续成长，营收达到新台币72.17亿元，较第三季及去年同期分别成长7%及5%，是继2019年第四季之后睽违两年再次创下单季历史新高纪录。在产能满载及产品组合的影响下，第四季毛利率为40.5%，优于原本的预期，每股盈余为新台币4.19元。2021年全年营收也再次登上历史高峰，达到新台币261.82亿元，年成长率为2%，全年每股盈余为新台币12.9元。

综观第四季的成长，在强劲的手机PA需求带动下，延续去年第三季美系新机发表的效应，除此之外，中国手机客户的需求也持续强劲，加上5G与低轨卫星相关基础建设的营收连续两季成长，成为第四季另一个营收成长动能及产品组合优化的重要关键。回顾全年，2021年稳懋凭借着先进的制程技术、卓越的产品生产良率及产能的优势，趁着中国智能型手机市场重新洗牌的同时抢占到先机，成为稳懋去年表现最为突出的成长动能。另外，2021年美系智能型手机在3D感测芯片上的微缩设计，让普遍市场分析不看好的出货量表现，反而因技术难度的提升而逆势成长，成为稳懋去年另一个成长的重要来源。印证了稳懋专注在技术上的领先及客户分散策略成功，就算面对市场上的起伏变化总能胜出。

面对新的一年，虽然全球仍受疫情的干扰，但放眼全球5G网络基础建设仍未臻完备，5G手机渗透率也仍低于4G，但是无论是物联网、AI及大数据的长期发展，还是从AR、VR演进到XR及Metaverse(元宇宙)，都仰赖具宽带、高速传输及低延迟特性的5G网络密度，稳懋持续看好5G未来几年的成长趋势不变、卫星通讯基础建设的持续布建。另外，稳懋在光通讯及光感测方面技术日渐成熟，不但累积更多经验，也吸引更多潜在客户的兴趣。凡此种种，稳懋都持续投入研发资源与客户紧密合作，期望成为下一个新应用导入的先驱。在产能扩充方面，稳懋C厂无尘室扩建工程将于上半年完工随即开始装机，新产能可望于下半年衔接旺季需求而开出。南科高雄园区路竹厂自去年中动土后，新厂建厂工程更是今年的重点工作，目标在2024年之内加入量产的行列。

在业绩成长的同时，稳懋仍然将企业永续及公司治理视为优先课题。2021年稳懋在国内不但再度蝉联第七届公司治理评鉴上柜组前5%公司，并荣获上市柜公司市值新台币100亿元以上电子业前10%之标竿企业，同时，也获颁第十四届TCSA「永续报告-白金奖」。在国际上，继2020年之后稳懋再度获选为道琼永续世界指数(DJSI World Index)企业，在日益重视ESG大趋势的国际市场，能够获选并持续与其他半导体龙头企业并列榜上，是对稳懋经营表现的认可，同时也是莫大的鼓励。

展望2022年第一季，因晶圆厂陆续岁休保养以及传统淡季，营收预期将较前一季下滑low-twenties 百分比，毛利率约为mid-thirties 的水平。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服

务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。